



2024年7月4日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

当社持分法適用会社（半導体ウエーハ）の上場申請取り下げに関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、当社の持分法適用関連会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下、「CCMC」）が、2022年8月18日に上海証券取引所科创板市場へ行った上場申請に関して、CCMCより上場審査状況などを総合的に勘案し上場申請を取り下げることとし、2024年7月3日に取引所より上場審査を終了する旨開示されましたので、お知らせいたします。

CCMCによる申請取り下げについては、最近の中国証券監督管理委員会のIPO審査の厳格化に伴い、上海証券取引所の要求事項への対応状況から総合的に判断されたものです。引き続き、CCMCは、適切な時期に株式上場申請の再開を含め、企業価値向上に繋がる最適な資本政策を多面的に検討してまいります。

なお、本件による当社の今期連結業績および財務状況に与える影響は軽微であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表します。

【ご参考】CCMC 関連開示の履歴（上場および出資に関する事項）

開示日	表題
2022/8/30	半導体ウエーハ持分法適用関連会社による上海証券取引所科创板市場への上場申請に関するお知らせ
2021/10/20	当社持分法適用関連会社（半導体ウエーハ事業）による海通証券（主幹事証券）との上場に関するアドバイザリー契約の締結、および中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ
2021/9/15	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の第三者割当増資（第二回）の払込完了に関するお知らせ
2021/9/15	（開示事項の訂正・変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回）および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021/7/15	（開示事項の変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回）および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021/6/30	（開示事項の訂正）半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021/6/29	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021/4/15	半導体ウエーハ持分法適用関連会社における第三者割当増資（第二回）、および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021/2/10	半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ
2020/11/13	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資のお知らせ
2020/11/13	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020/11/5	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の株式譲渡代金の払込完了のお知らせ
2020/11/2	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020/10/19	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の株式譲渡代金払込完了のお知らせ
2020/10/16	半導体ウエーハ子会社による第三者割当増資に関するお知らせ
2020/9/17	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ
2020/9/15	半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ

以 上